



Electronics for the Future

決算発表 補足資料

2024年度 第3四半期業績

2025年2月3日
ローム株式会社
広報IR部

2024年度 第3四半期 実績 業績報告 (前年同期比)



(単位：億円)

	FY2024 第3四半期 実績	FY2023 第3四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,126	1,158	▲32	▲2.8%
営業利益	▲101	108	▲209	-
(対売上比率)	(▲9.0%)	(9.3%)	-	-
経常利益	4	100	▲96	▲95.5%
(対売上比率)	(0.4%)	(8.7%)	-	-
純利益	▲18	77	▲95	-
(対売上比率)	(▲1.6%)	(6.7%)	-	-
EBITDA	110	302	▲192	▲63.3%
(対売上比率)	(9.9%)	(26.1%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (151.32円) (147.00円)

期末レート(¥/US\$) (158.18円) (141.83円)

(単位：億円)

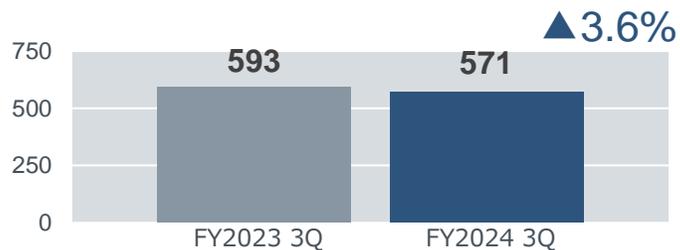
四半期売上高

1,158億円 ▲2.8%
1,126億円

FY2023 第3四半期
実績

FY2024 第3四半期
実績

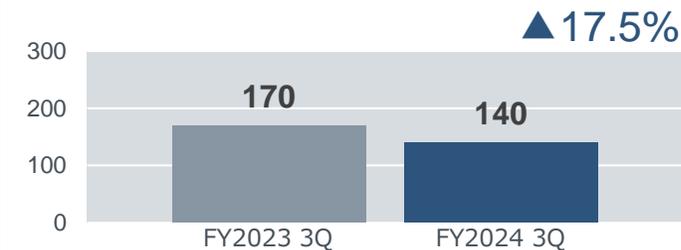
自動車



- インフォテインメント分野 ▲1
- ボディ分野 ▲7
- パワートレイン分野 +2
- 安全走行ADAS分野 +3
- xEV分野 ▲20
- その他 +2



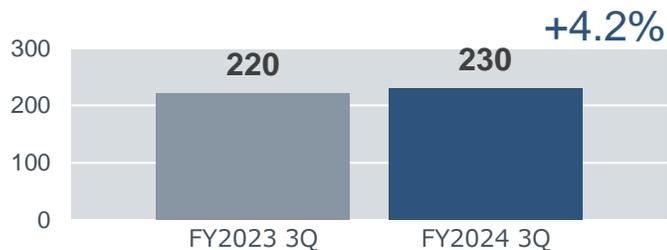
産機



- FA分野 ▲9
- エネルギー分野 ▲9
- ホームビルディング分野 ▲2
- その他 ▲10



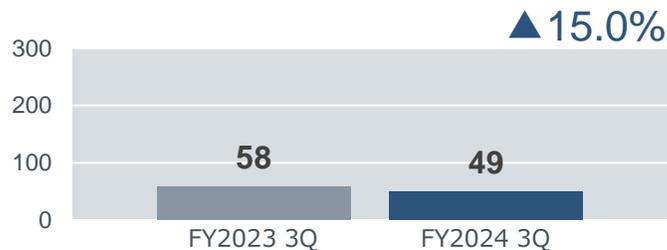
民生



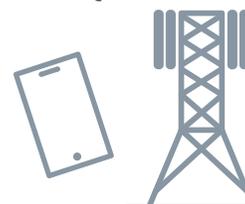
- AV関連 ▲2
- 家電分野 +5
- その他 +7



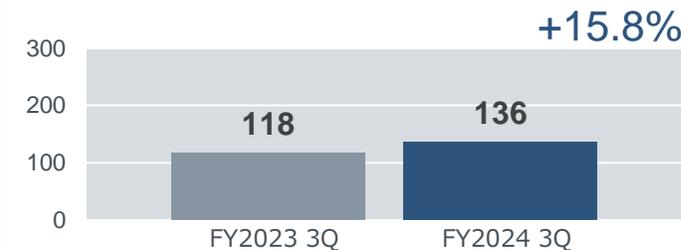
通信



- スマホ&モバイル分野 ▲6
- 基地局&インフラ分野 ▲2
- 有線通信分野 ▲1



コンピュータ & ストレージ



- PC&サーバー分野 +12
- 決済端末向け ▲1
- 事務機分野 +8



2024年度 第3四半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)

四半期売上高

1,158億円

1,126億円

FY2023 第3四半期実績

FY2024 第3四半期実績

▲2.8%

海外売上高比率

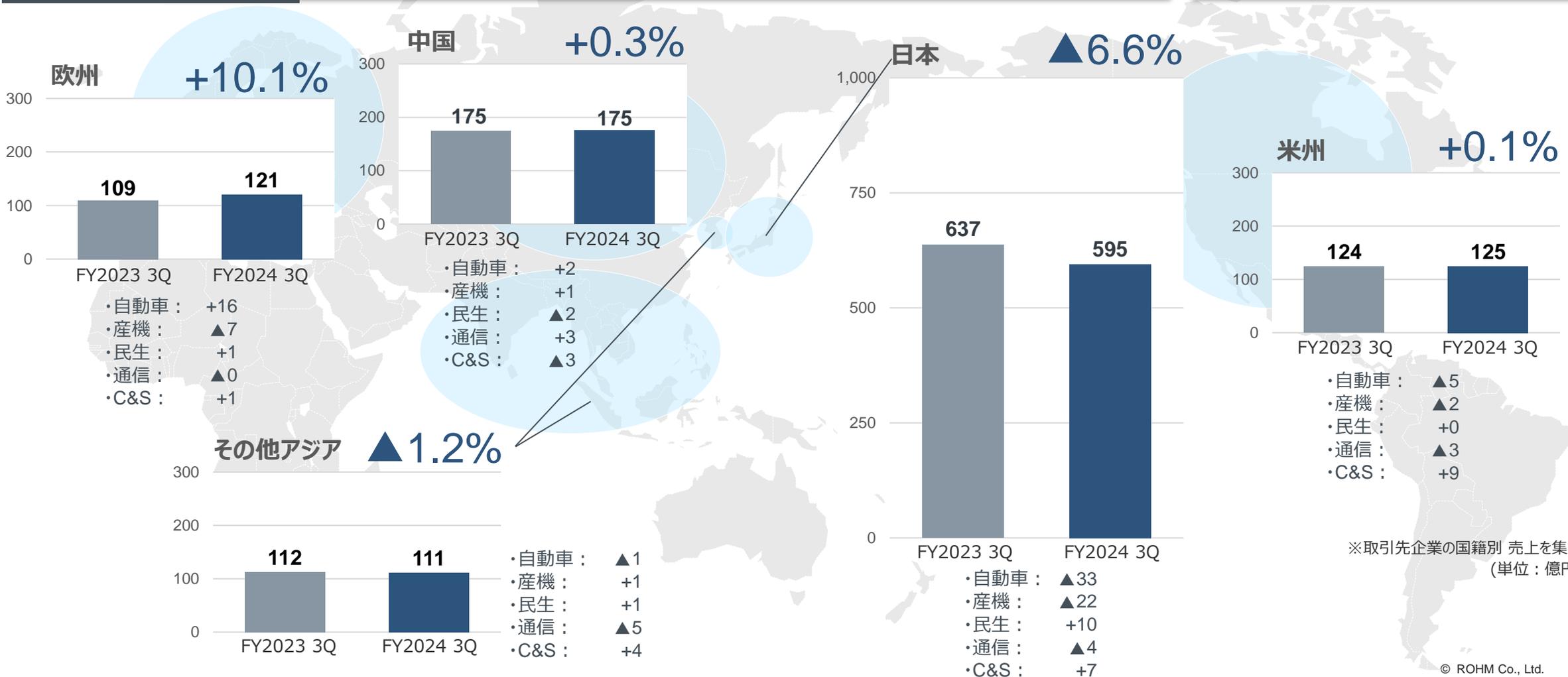
45.0%

FY2023 第3四半期

47.2%

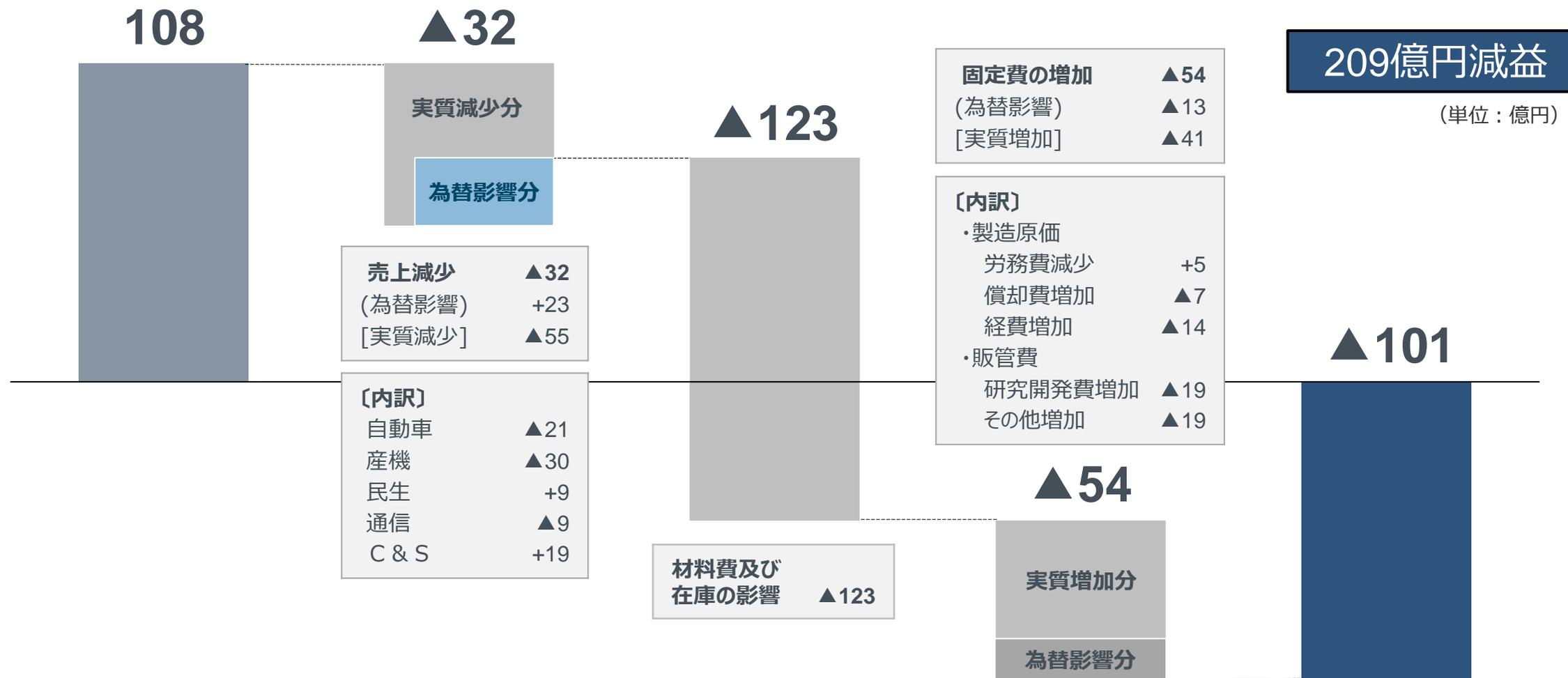
FY2024 第3四半期

第3四半期 前年同期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

2024年度 第3四半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)



209億円減益

(単位：億円)

▲101

FY2023 3Q 実績

(147.00円)

期中平均レート
(¥/US\$)

FY2024 3Q 実績

(151.32円)

2024年度 第3四半期 セグメント別 (前年同期比)

(単位：億円)

		FY2024 第3四半期 実績	FY2023 第3四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	516	511	+5	+0.9%
	セグメント利益	▲15	56	▲71	-
	(利益率)	(▲3.0%)	(11.0%)	-	-
半導体素子	売上	468	495	▲27	▲5.5%
	セグメント利益	▲100	15	▲115	-
	(利益率)	(▲21.5%)	(3.1%)	-	-
モジュール	売上	79	86	▲7	▲8.3%
	セグメント利益	5	1	+4	+253.4%
	(利益率)	(7.1%)	(1.8%)	-	-
その他	売上	61	63	▲2	▲3.6%
	セグメント利益	3	4	▲1	▲16.7%
	(利益率)	(5.9%)	(6.8%)	-	-

2024年度 第3四半期 実績 業績報告 (直前四半期比)

(単位：億円)

	FY2024 第3四半期 実績	FY2024 第2四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,126	1,137	▲11	▲1.0%
営業利益	▲101	▲22	▲79	-
(対売上比率)	(▲9.0%)	(▲2.0%)	-	-
経常利益	4	▲93	+97	-
(対売上比率)	(0.4%)	(▲8.2%)	-	-
純利益	▲18	▲13	▲5	-
(対売上比率)	(▲1.6%)	(▲1.2%)	-	-
EBITDA	110	183	▲73	▲39.4%
(対売上比率)	(9.9%)	(16.1%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (151.32円) (150.26円)

期末レート(¥/US\$) (158.18円) (142.73円)

(単位：億円)

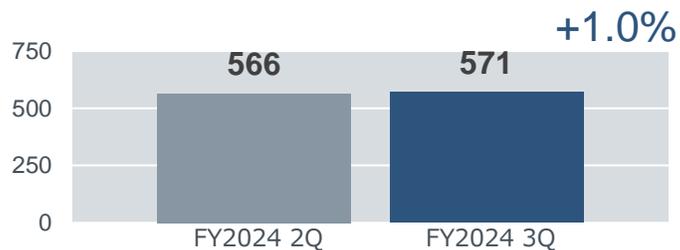
四半期売上高

1,137億円 ▲1.0%
1,126億円

FY2024 第2四半期
実績

FY2024 第3四半期
実績

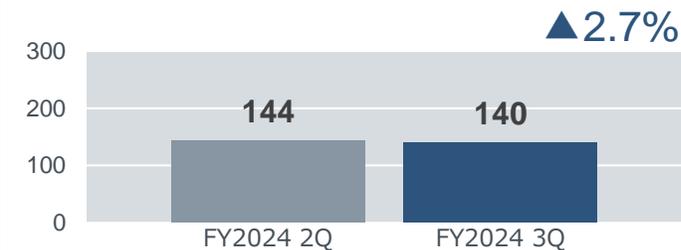
自動車



- インフォテインメント分野 +1
- ボディ分野 +2
- パワートレイン分野 +6
- 安全走行ADAS分野 ▲3
- xEV分野 +1
- その他 ▲2



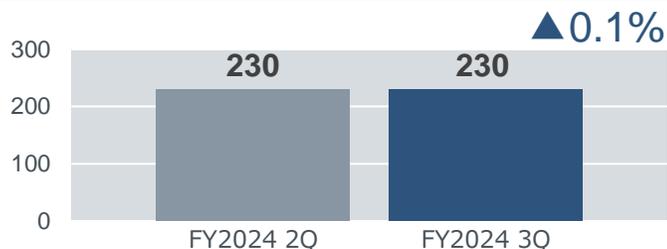
産機



- FA分野 +1
- エネルギー分野 ▲2
- ホームビルディング分野 +0
- その他 ▲3



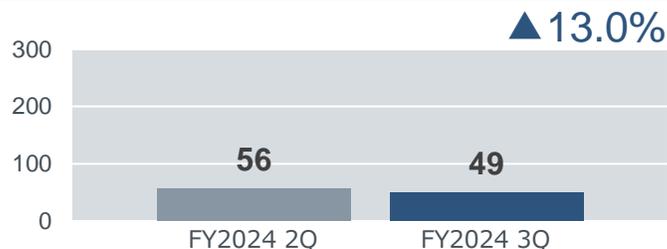
民生



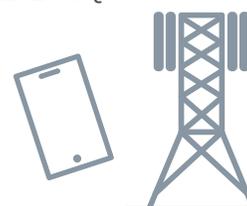
- AV関連 ▲0
- 家電分野 +6
- その他 ▲6



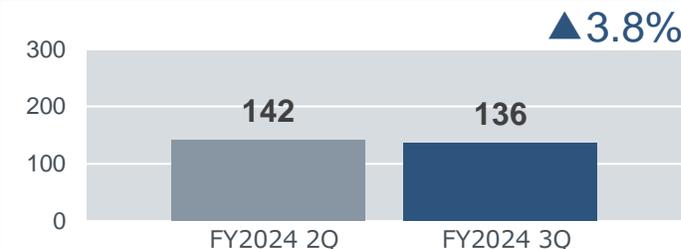
通信



- スマホ&モバイル分野 ▲6
- 基地局&インフラ分野 ▲1
- 有線通信分野 ▲0



コンピュータ & ストレージ



- PC&サーバー分野 ▲6
- 決済端末向け ▲2
- 事務機分野 +3



2024年度 第3四半期 国籍別 売上の変動要因 (直前四半期比)

四半期売上高

1,137億円

1,126億円

FY2024 第2四半期実績

FY2024 第3四半期実績

▲1.0%

海外売上高比率

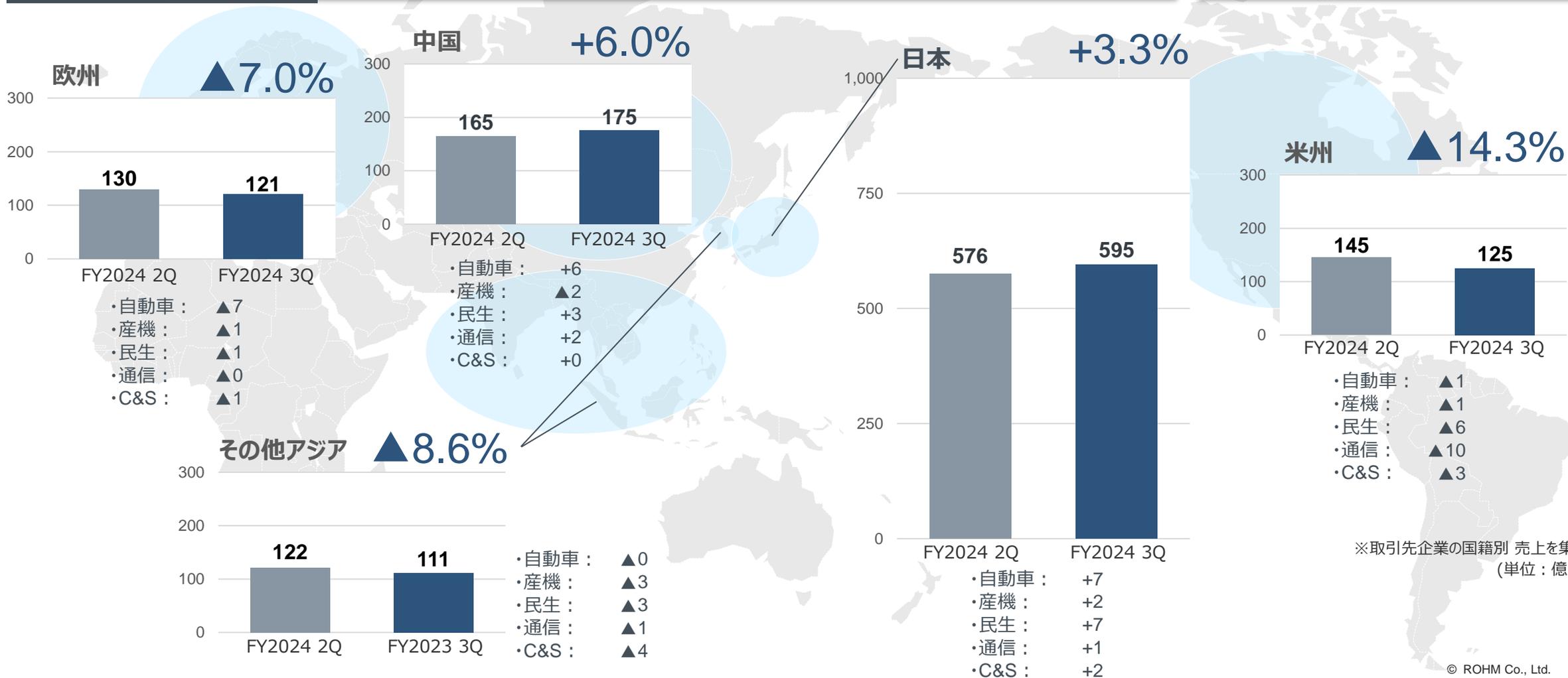
49.4%

FY2024 第2四半期

47.2%

FY2024 第3四半期

第3四半期 直前四半期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

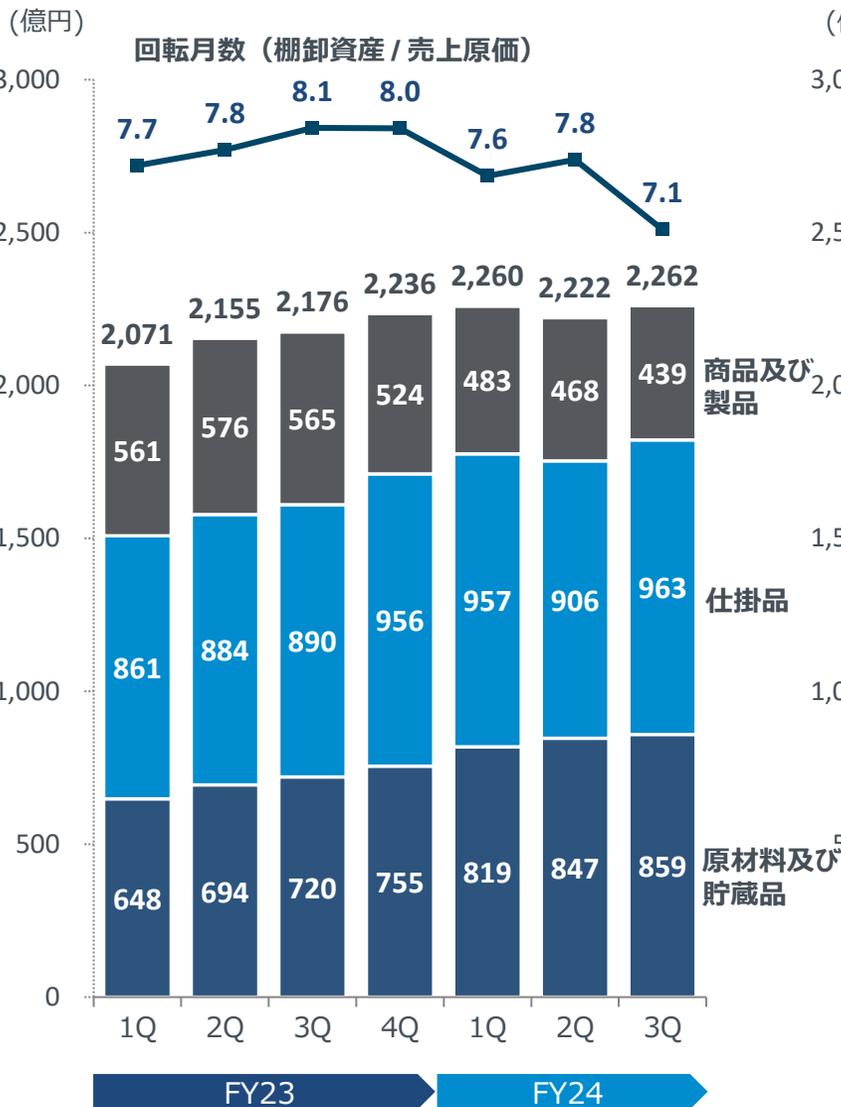
2024年度 第3四半期 セグメント別 (直前四半期比)

(単位：億円)

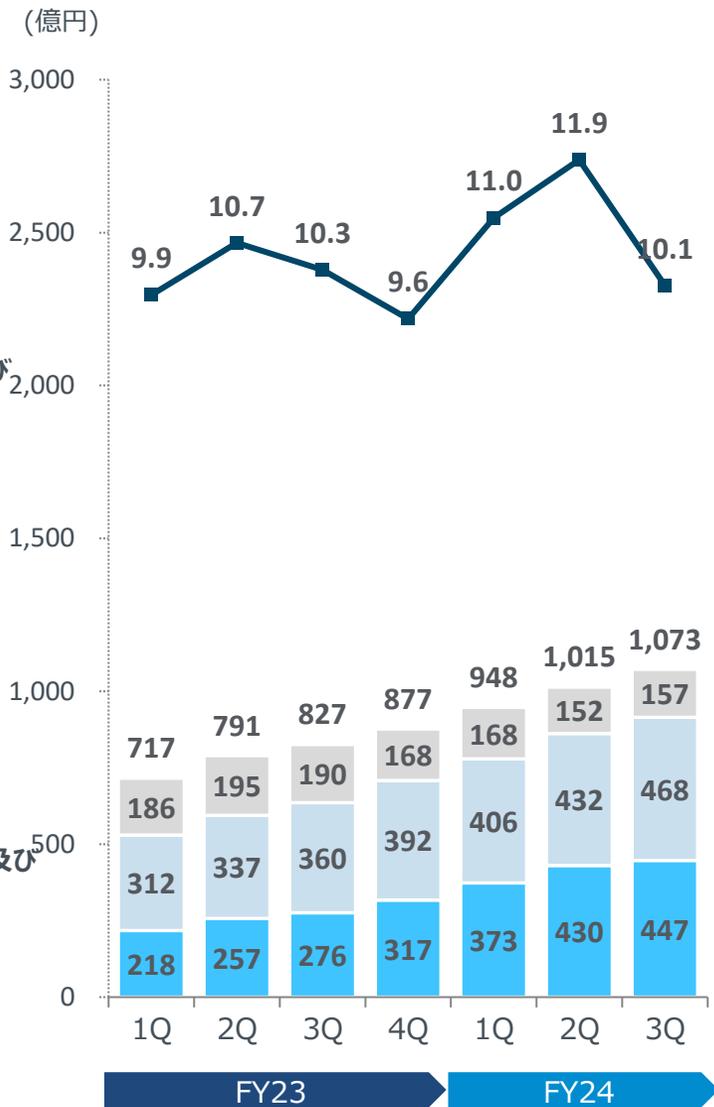
		FY2024 第3四半期 実績	FY2024 第2四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	516	504	+12	+2.3%
	セグメント利益	▲15	15	▲30	-
	(利益率)	(▲3.0%)	(3.0%)	-	-
半導体素子	売上	468	483	▲15	▲3.0%
	セグメント利益	▲100	▲54	▲46	-
	(利益率)	(▲21.5%)	(▲11.3%)	-	-
モジュール	売上	79	87	▲8	▲9.9%
	セグメント利益	5	13	▲8	▲58.8%
	(利益率)	(7.1%)	(15.5%)	-	-
その他	売上	61	61	+0	+0.2%
	セグメント利益	3	8	▲5	▲56.2%
	(利益率)	(5.9%)	(13.4%)	-	-

在庫の状況 (連結合計)

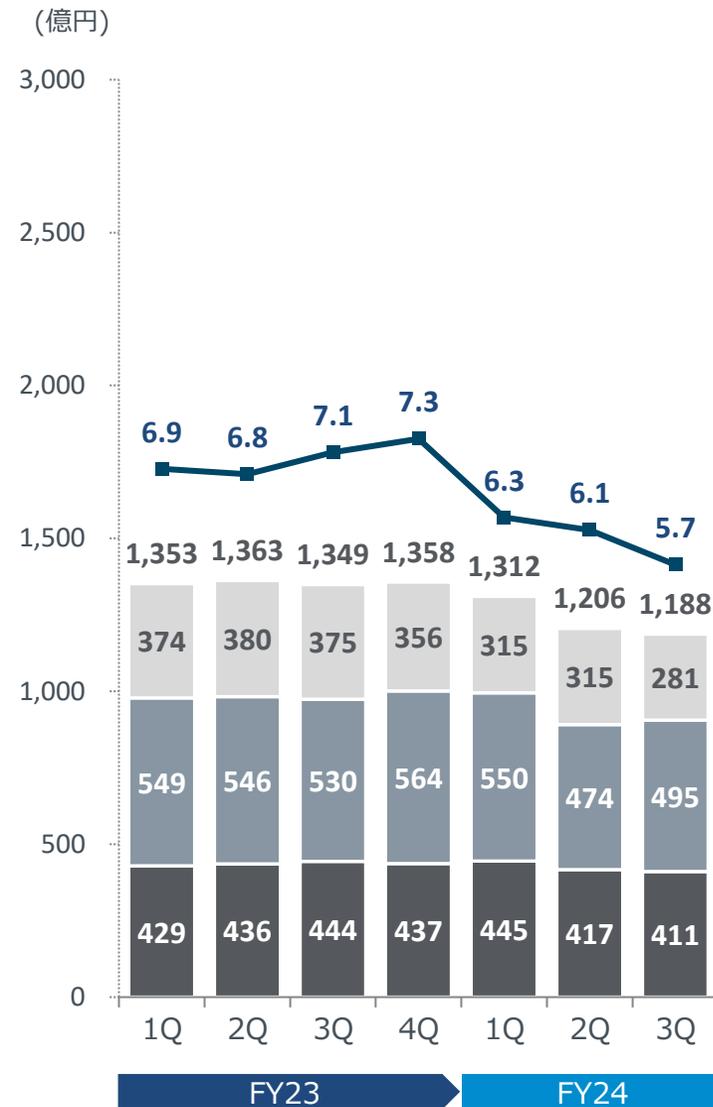
連結合計



パワーデバイス



パワーデバイス以外



通期の業績予想について

【ご参考】 2024年11月8日公表 修正計画値

(単位：億円)

	FY2024 修正計画	FY2023 実績	増減額	増減率
売上高	4,500	4,677	▲177	▲3.8%
営業利益	▲150	433	▲583	-
(対売上比率)	(▲3.3%)	(9.3%)	-	-
経常利益	▲100	692	▲792	-
(対売上比率)	(▲2.2%)	(14.8%)	-	-
純利益	▲60	539	▲599	-
(対売上比率)	(▲1.3%)	(11.5%)	-	-
EBITDA	742	1,153	▲411	▲35.7%
(対売上比率)	(16.5%)	(24.7%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (151.32円) (150.26円)

期末レート(¥/US\$) (158.18円) (142.73円)

Question	Answer
3Qの月次売上高は？	10月:382億円、11月:370億円、12月:353億円。なお、為替による決算修正が+20億円発生しております。
稼働率の状況は？ 今後の在庫レベルは？	3Qにおいても、稼働を抑制し製品在庫の圧縮を継続いたしました。SiCパワーデバイス事業につきましては、生産量の増加とともに在庫水準も上がっていく方向に向かいますが、その他事業につきましては現状の在庫水準を維持しながら需要の回復に合わせて稼働を引き上げていきます。原材料につきましてはLTAの見直しなどを進め、適正在庫まで圧縮を進めます。
3Qの売上・利益は計画に対してどうだった？	売上に関しては、為替が想定よりも円安に進んだことも受け全体として約4%上振れとなりました。利益に関しては、売上の上振れに加え、固定費削減策の効果がプラスに働いたものの、3Qも継続して稼働を抑制し製品在庫の圧縮を進めた結果、想定よりも下振れの結果となりました。2Q末時点の在庫水準を維持していく方針でしたが、先行きの需要見通しが想定よりも厳しく、更なる在庫圧縮が必要と判断いたしました。
前年同期比・直前四半期で在庫材料費が営業利益に大きく悪影響を与えている要因は？	3Qにおいても、稼働を抑制し製品在庫の圧縮を継続したことにより、在庫変動の影響がネガティブに発生しております。また、稼働調整を開始した後に生産された固定費負担の高い在庫が払い出されたことが、売上原価を押し上げる要因となっております。
半導体素子部門の利益が赤字になった理由は？	半導体サイクルによる需要の調整局面であることに加え、SiCパワーデバイスの生産能力増強のための投資を継続していることによる償却負担増、8インチライン開発のための研究開発費の負担増によるものです。
足元の需要動向は？ 4Qの市場別の見通しは？	依然として各市場において調整局面が継続する見込みであり、本格的な回復は来年度以降になると見ております。
SiC事業の3Qの進捗と今後の見通しは？	3Qにおいては、自動車向けSiCデバイスについては堅調に推移したものの、基板の外販については顧客要因により大きく調整局面となりました。EV市場の調整が継続していることを受け、依然としてSiC市場は従来よりも厳しい局面が続くものと思われます。しかし、中長期的なSiCへの期待は不変であり、着実に成長を続けていけると考えております。
通期業績の見通しは？	売上高については計画に対して順調に推移しておりますが、先行きの見通しが不透明であること、また収益性改善に向けた構造改革を進めている中、合理的な算定が困難な状況であります。今後公表済みの業績予想に変更が必要と判断される際には、改めて業績予想の修正を行います。

Question	Answer
来年度の市況の見え方は？	先行きは依然として不透明感が強く、来年度前半においては調整局面が継続するものと思われます。しかし、現在が市況のボトムであると考えており、来年度中には市況が回復に転じると見ています。これまでの設備投資により十分な生産能力を確保できておりますので、市況の回復に乗り遅れないよう準備を進めてまいります。
為替感応度は？	ドルに対して円安に動くと、業績にはプラスに働きます。 1円動くと、年間ベースで売上高21億円、営業利益8億円変動します。
社長が交代することで経営方針・戦略に変化は？	当面は、業績回復に向けた抜本的な構造改革に注力し、どのような環境下でも安定して利益を出せる経営基盤づくりに取り組んでまいります。詳細につきましては、就任後の決算説明会時にお伝えしたいと考えております。
上期決算で発表した収益性改善の施策、工場再編の進捗は？	既に価格適正化、不採算製品の統廃合、人員の適正化を進めております。また、生産拠点再編の一環として、材料事業（Siウエハ事業）の撤退を決定しました。現在、土地や装置など資産売却等も含めて検討しているところです。生産拠点再編については、今後その規模を拡大するなど、より踏み込んだ構造改革にも取り組んでまいります。このように業績回復に向け、あらゆる可能性を排除せず検討しており、当期の業績予想については現時点で合理的な算定が困難であることから据え置いております。
東芝との協業について進捗は？	2024年7月より東芝、及び日本産業パートナーズ（JIP）と業務提携強化に向けた協議を開始し、現在も継続しております。社長交代に伴う影響はありません。
デンソーとの協業について進捗は？	現在、先方と協議を進めている状況です。社長交代に伴う影響はありません。
米新政権によるEV促進策の撤回、関税の影響は？	現状において、ロームにどれだけの影響を及ぼすのか把握できておりませんが、リスクは想定しておく必要があり、特定の市場や地域に依存しないようリスクの極小化に努めてまいります。

- [2024-11-07 車載電動コンプレッサや産業機器インバータ等の高効率化に貢献業界トップクラス*の低損失特性・高短絡耐量を実現した1200V IGBTを開発](#)
- [2024-11-12 独自設計のパッケージで絶縁耐性を大幅に向上！xEVシステムの高電圧化にも対応したSiCショットキーバリアダイオードを開発](#)
- [2024-11-19 ダウンサイジングを実現する新汎用チップ抵抗器「MCRxシリーズ」を開発](#)
- [2024-11-21 ロームのSoC向けPMICが、総合半導体ファブレスメーカーTelechipsの次世代コックピット向け電源リファレンスデザインに採用](#)
- [2024-11-26 ヴァレオとロームが次世代パワーエレクトロニクス分野で共同開発](#)
- [2024-12-10 ロームとTSMC、車載GaNに関する戦略的パートナーシップを締結](#)
- [2024-12-18 自動運転を支える高速車載通信システム「CAN FD」に対応したTVSダイオード「ESDCANxxシリーズ」を開発](#)
- [2024-12-25 ESG投資指数「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index」構成銘柄に初選定](#)
- [2025-01-17 代表取締役の異動に関するお知らせ](#)
- [2025-01-23 A4サイズモバイルプリンター向け小型サーマルプリントヘッドを開発](#)
- [2025-01-30 650V耐圧GaN HEMTに小型・高放熱のTOLLパッケージが登場！](#)



Electronics for the Future